

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
27. Februar 2014 (27.02.2014)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2014/029417 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

H01L 23/04 (2006.01) *H01L 21/50* (2006.01)
H01L 21/48 (2006.01) *H01L 21/683* (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2012/066194

(22) Internationales Anmeldedatum:
20. August 2012 (20.08.2012)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **EV GROUP E. THALLNER GMBH** [AT/AT];
DI Erich Thallner Straße 1, A-4782 St. Florian am Inn
(AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **MATTHIAS, Torsten**
[AT/AT]; Marktplatz 87, A-4752 Riedau (AT).

(74) Anwälte: **SCHWEIGER, Johannes** et al.; Turmstraße 22,
40878 Ratingen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,
DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN,
KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: PACKING FOR MICROELECTRONIC COMPONENTS

(54) Bezeichnung : VERPACKUNG FÜR MIKROELEKTRONISCHE BAUTEILE

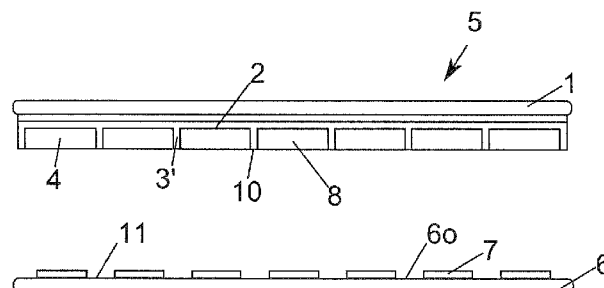


Fig. 5

(57) Abstract: The invention relates to packing for microelectronic components (7) mounted on a structured substrate (6), the packing having: a carrier substrate (1) with a packing-receiving surface (1v), wherein an anti-adhesion layer (2) is applied at least predominantly to the packing-receiving surface (1v); and a structured material (3') with chamber openings (4) for receiving the microelectronic components (7) applied to the anti-adhesion layer (2). The present invention also relates to methods for producing such packing, methods for packing and a method for detaching the carrier substrate.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Verpackung für auf einem Struktursubstrat (6) aufgebrachte mikroelektronische Bauteile (7) mit: - einem Trägersubstrat (1) mit einer Verpackungsaufnahmeffläche (1v), wobei auf der Verpackungsaufnahmeffläche (1v) zumindest überwiegend eine Antihafschicht (2) aufgebracht ist, - einem auf der Antihafschicht (2) aufgetragenen Strukturmaterial (3') mit Kammeröffnungen (4) zur Aufnahme der mikroelektronischen Bauteile (7). Weiterhin betrifft die vorliegende Erfindung Verfahren zur Herstellung einer solchen Verpackung sowie Verfahren zum Verpacken und ein Verfahren zum Ablösen des Trägersubstrats.



WO 2014/029417 A1